

適用規格					
定格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）	
	使用湿度範囲	40%～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40%～ 70%（注3）	
	電 圧	AC/DC 100V	適合コネクタ	DF20%-*DS-1C(##)	
	電 流	AWG28: 1.0A/pin AWG30: 0.9A/pin AWG32: 0.7A/pin	適合圧着端子	DF20%-****SCFA(##)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	低電圧、低電流下の接触抵抗	20 mV 以下、1 mA（DC又は 1000 Hz）で測定する。	30 mΩ 以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ 以上	○	—
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10 サイクル試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 500MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し替えの時間は2～3分 （室温に1～2時間放置後測定）	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 500MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐熱性	温度 +85±2℃中に96時間放置する。	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 500MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐寒性	温度 -55±3℃中に96時間放置する。	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 500MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
備考					
(注1) 通電時の温度上昇を含みます。					
(注2) 結露がないこと。					
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。			承認	HS. OKAWA	20200310
			検 図	SZ. ONO	20200310
			担 当	SN. MIWA	20200310
			製 図	DS. HIROWATARI	20200306
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-311790-52-00	
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DF20F-*DP-1H(52)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード		△ 1/2

性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
環境的性能	はんだ耐熱性	【リフローはんだ付けの場合】 以下の温度条件で2回のリフローを行う。 リフロー部：ピーク温度250℃ 10秒以内 220℃以上 60秒以下 予熱部：150～180℃ 60～120秒 【手はんだ付けの場合】 はんだごて温度300℃、3秒の条件にて はんだ付けを行う。 但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 245℃、浸漬時間 5秒間 のはんだ付けを行なう。	はんだ浸漬面の 95 %以上が 新しいはんだで濡れていること。	○	—
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-311790-52-00	
HRS	製品規格表		製品名	DF20F-*DP-1H(52)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	△	2/2